

第17回 有機/無機接合研究委員会

日時：2023年6月27日（火）13:00～16:05

場所：日本橋ライフサイエンスビルディング 9階 911-913 会議室（東京都中央区）

プログラム

司会 木村 文信（東京大学）

13:00～13:10 委員会議事

13:10～13:50

『表面活性化接合の新しい展開』（40分）

..... ○松本 好家（ランテクニカルサービス(株)）

13:50～14:30

『バンプレス接合による Wafer-On-Wafer 積層のための高耐熱性樹脂および仮接合樹脂の開発』（40分）

..... ○新木 直子^{*1*2}、伊藤 大祐^{*1}、福田 匡志^{*2}、大場 隆之^{*2}
（^{*1} (株)ダイセル、^{*2} 東京工業大学）

14:30～14:45 休憩

司会 藤野 純司（三菱電機(株)）

14:45～15:25

『車載パワーモジュールの実装動向と材料技術』（40分）

..... ○石井 利昭（日立 Astemo(株)）

15:25～16:05

『フィルム型コネクタの接続信頼性に及ぼす粘着剤の影響とその応用』（40分）

..... ○三井 亮介、吉良 敦史、中島 伸一郎（日本航空電子工業(株)）

（ ）内時間は、質疑応答時間を含む

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。

一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会